

WS715M 水溶性液态助焊剂

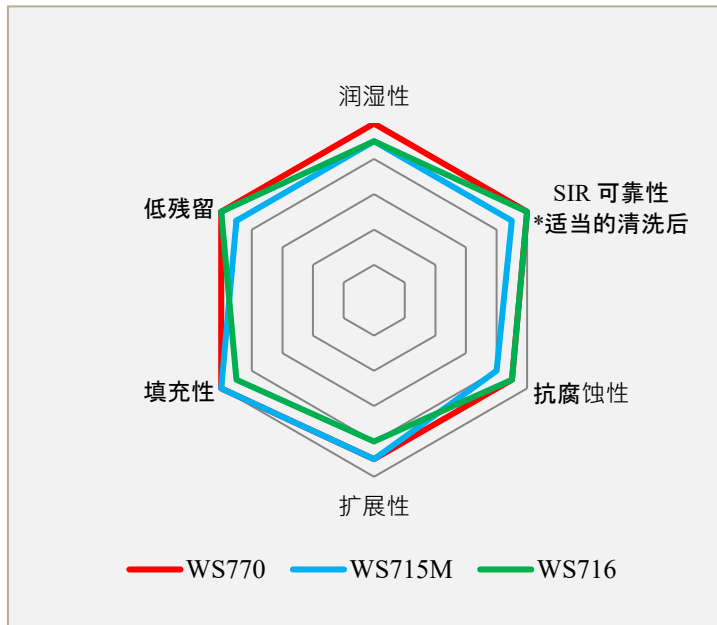
特性

- ▶ 良好的润湿性
- ▶ 兼容无铅和含铅产品
- ▶ 使用去离子水易于清洗
- ▶ 清洗时泡沫少
- ▶ PH 值中性

描述

WS715M 是一款醇基、有机活化、无松香的水溶性液态助焊剂，专为波峰焊和选择焊工艺开发，可通过喷涂、发泡、浸渍或刷涂方式涂覆。该助焊剂为 pH 中性配方，含高稳定性活化剂，润湿性能优异，即便在难以润湿的材料表面，也能形成光亮、平滑的焊点。WS715M 适用于所有表面镀层，包括 ENIG、OSP 和 HASL 等处理。WS715M 的焊后残留物必须清除。

特点



处理及储存

参数	时间	温度
密封储存保质期	1 年	室温

WS715M 在室温下密封储存，保质期为 1 年。请勿靠近明火或火焰存放；避免阳光直射，以防产品降解。WS715M 为即用型产品，无需混合；禁止将用过的化学品与未使用的化学品混入同一容器；开封后需重新密封容器。储存温度范围为 4-40° C (40-100°F)。

应用

WS715M 可通过喷涂、发泡、刷涂或浸渍方式涂覆，直接从容器中取出即可使用，无需稀释。采用喷涂方式涂覆时，必须保证助焊剂覆盖均匀且充分，干燥助焊剂覆盖起始时建议每平方英寸涂抹 500-1500 毫克。

工艺指导

将热电偶贴附于 PCB 的上表面，其温度应该在 85-110°C (185-230°F) 之间。确保助焊剂在接触波峰前完全烘干，预热未干的助焊剂会引起飞溅。少量出烟是正常现象。推荐的接触时间取决于波峰配置、炉温、合金类型和元件的热质量。通常为 3 - 8 秒。如需工艺支持，请通过 <https://www.aimsolder.com/contact> 联系 AIM 技术支持团队。

清洁

WS715M 残留物必须使用去离子水或使用去离子水配合适当的清洗剂。推荐使用去离子水做最终冲洗，建议在加工完成后 8 小时内清洗电路板。如需更多信息，请联系 AIM。

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询 AIM 相关条款。

安全
使用时需保证充足通风，并佩戴适当的个人防护装备。有关特定应急信息，请参考随附的《安全数据表》（SDS）。切勿将危险材料倒入未经批准的容器中处理。

测试数据小结

名称	测试方法	结果
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ORH1
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1	ORH1
名称	测试方法	结果
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	高
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	高
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	>2.0
定量卤化物，铬酸银	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	存在卤化物
定量卤化物，氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟
表面绝缘电阻（清洗后）	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过
	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	12.0 典型值
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	25.9 mg KOH per gram flux 典型值
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.80-0.85 (水 = 1)
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	透明，无色
润湿性	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。